

G-551无铅介质浆料

概述:

G-551 是一款**无铅环保型**包封介质浆料, 用于厚膜电路、电阻器、传感器等电子元器件的无铅包封。在陶瓷等电子元器件表面附着力好, 膜层致密性好, 耐溶剂性好, 机械强度高, 能够改善厚膜电阻的激光调阻性能。

主要技术指标:

项 目	测试方法	技术指标
粘 度 (Pa·s)	BROOKFIELD SC4-14 10RPM, 25°C	150-250
细 度	刮板细度规测试	≤8μm
色 调	目测	浅绿色
烧结膜耐酸性	5%H ₂ SO ₄ 溶液, 浸泡30min, 目测与标准样品 比对。	良好

推荐工艺与使用说明:

印刷丝网: 200 ~ 325目不锈钢丝网、乳胶厚度 8 ~ 15μm,

印刷刮板: 聚氨酯刮板, 硬度60 ~ 80 ,

烧结膜厚度: 8-11μm

干燥条件: 100-125°C, 10 min。

烧结条件: 520-530°C, 峰值5 min (烧结条件可结合实际使用条件和需求适当调整)。

粘度调整: 最好使用专用稀释剂稀释, 用量不超过1%。

储存条件: 贮藏于5-10°C冷藏柜中, 保质期6个月。

使用建议: 浆料未开封条件下充分回温, 印刷前用刮刀搅拌均匀;

产品使用场地洁净、通风良好。